

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4046458号  
(P4046458)

(45) 発行日 平成20年2月13日(2008.2.13)

(24) 登録日 平成19年11月30日(2007.11.30)

(51) Int.Cl.	F 1
H01L 21/027	(2006.01)
B65G 49/06	(2006.01)
G03F 7/16	(2006.01)
G03F 7/30	(2006.01)
H01L 21/677	(2006.01)
	HO1L 21/30 562
	B65G 49/06 Z
	GO3F 7/16 502
	GO3F 7/30 502
	HO1L 21/68 A

請求項の数 6 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2000-153321 (P2000-153321)
(22) 出願日	平成12年5月24日 (2000.5.24)
(65) 公開番号	特開2001-332483 (P2001-332483A)
(43) 公開日	平成13年11月30日 (2001.11.30)
審査請求日	平成17年4月12日 (2005.4.12)

(73) 特許権者	000219967 東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂五丁目3番6号
(74) 代理人	10009944 弁理士 高山 宏志
(72) 発明者	荒木 真一郎 熊本県菊池郡大津町大字高尾野字平成27 2番地の4 東京エレクトロン九州株式会 社 大津事業所内

審査官 星野 浩一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 处理ユニットおよび処理システム

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

搬送路に沿って基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが配置され、搬送路を移動する搬送装置により前記搬送路に沿って設けられた各処理ユニットに対する基板の搬送を行い、基板に対して一連の処理を行う第1の処理装置と、

基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが処理の順に配列され、これら複数の処理ユニットに基板を順次搬入して、基板に対して一連の処理を行う第2の処理装置との両方に搭載可能な処理ユニットであって、

外装をなす矩形状の筐体と、

前記筐体内に基板を搬入出するため、前記筐体の側面をなす第1の面に設けられた基板搬入口と、

前記筐体内に基板を搬入するため、前記筐体の側面をなす第1の面と直交する第2の面に設けられた基板搬入口と、

前記筐体内から基板を搬出するため、前記筐体の側面をなす、前記第2の面と対向する第3の面に設けられた基板搬出ロッ

トを有し、

前記第1の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口を介して基板の搬入出が行われ、前記第2の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口から基板が搬入され前記基板搬出ロッ

## 【請求項 2】

前記基板搬入口は前記第2の面に1カ所のみ設けられていることを特徴とする請求項1に記載の処理ユニット。

【請求項3】

前記基板搬入出口は前記第1の面に2カ所設けられ、その一方は前記筐体内に基板を搬入するために用いられ、他方が前記筐体内から基板を搬出するために用いられることを特徴とする請求項1に記載の処理ユニット。

【請求項4】

前記処理ユニットは、基板にレジストを塗布するレジスト塗布処理ユニット、または、基板を現像処理する現像処理ユニット、または基板を洗浄する洗浄ユニット、または、基板を加熱または冷却処理する熱処理ユニットのいずれかであることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の処理ユニット。

10

【請求項5】

搬送路に沿って基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが配置され、搬送路を移動する搬送装置により前記搬送路に沿って設けられた各処理ユニットに対する基板の搬送を行い、基板に対して一連の処理を行う第1の処理装置と、

基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが処理の順に配列され、これら複数の処理ユニットに基板を順次搬入して、基板に対して一連の処理を行う第2の処理装置と、を具備する処理システムであって、

前記第1の処理装置および前記第2の処理装置は、いずれにも搭載可能な処理ユニットを有しており、それらは入れ替え可能に構成されており、

20

前記いずれにも搭載可能な処理ユニットは、

外装をなす矩形状の筐体と、

前記筐体内に基板を搬入出するために、前記筐体の側面をなす第1の面に設けられた基板搬入口と、

前記筐体内に基板を搬入するために、前記筐体の側面をなす、前記第1の面と直交する第2の面に設けられた基板搬入口と、

前記筐体内から基板を搬出するために、前記筐体の側面をなす、前記第2の面と対向する第3の面に設けられた基板搬出口と、

を有し、

前記第1の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口を介して基板の搬入出が行われ、前記第2の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口から基板が搬入され前記基板搬出口から基板が搬出されることを特徴とする処理システム。

30

【請求項6】

前記いずれにも搭載可能な処理ユニットは、着脱自在であることを特徴とする請求項5に記載の処理システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本発明は、例えばLCDガラス基板等の基板に対してレジスト塗布、露光および現像処理のような複数の処理を施す処理装置に用いられる処理ユニットおよびそれが用いられる処理システムに関する。

40

【0002】

【従来の技術】

液晶表示装置(LCD)の製造においては、基板であるLCDガラス基板に、所定の膜を成膜した後、フォトレジスト液を塗布してレジスト膜を形成し、回路パターンに対応してレジスト膜を露光し、これを現像処理するという、いわゆるフォトリソグラフィー技術により回路パターンを形成する。

【0003】

このフォトリソグラフィー技術では、被処理体であるLCD基板は、アドヒージョン(疎水化)処理 レジスト塗布 プリベーカ 露光 現像 ポストベーカという一連の処理

50

を経てレジスト層に所定の回路パターンを形成する。

【0004】

従来、このような処理は、各処理を行う処理ユニットを搬送路の両側にプロセスフローを意識した形態で配置し、搬送路を走行可能な搬送装置により各処理ユニットへの被処理体の搬入出を行いういわゆる中央搬送タイプの処理装置、または各処理を行う処理ユニットを処理の順に配置し、これら複数の処理ユニットに基板を順次搬入して処理を行いういわゆるトラック搬送タイプの処理装置によって行われている。

【0005】

中央搬送タイプの処理装置においては、中央の搬送路を走行する搬送装置により各処理ユニットに対する基板の搬入出が行われるため、各処理ユニットは搬送路に面した部分の一箇所のみに基板の搬入出口が設けられている。一方、トラック搬送タイプの処理装置の場合には一方向に基板が流れるため、各処理ユニットには流れる方向の上流側と下流側の二箇所に搬入出口が設けられている。

10

【0006】

したがって、同じ処理を行う処理ユニットであっても、中央搬送タイプの処理装置に搭載するものとトラック搬送タイプの処理装置に搭載するものとではその構造が異なっている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このように中央搬送タイプの処理装置用の処理ユニットと、トラック搬送タイプの処理装置用の処理ユニットで異なる構造の処理ユニットを造り分けることは極めて煩雑であり、効率も悪い。

20

【0008】

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、中央搬送タイプの処理装置にもトラック搬送タイプの処理装置にも適用することができる処理ユニットを提供することを目的とする。また、そのような処理ユニットを適用した処理システムを提供することを目的とする。

【0010】

【発明が解決しようとする手段】

上記課題を解決するために、本発明の第1の観点では、搬送路に沿って基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが配置され、搬送路を移動する搬送装置により前記搬送路に沿って設けられた各処理ユニットに対する基板の搬送を行い、基板に対して一連の処理を行う第1の処理装置と、

30

基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが処理の順に配列され、これら複数の処理ユニットに基板を順次搬入して、基板に対して一連の処理を行う第2の処理装置との両方に搭載可能な処理ユニットであって、

外装をなす矩形状の筐体と、

前記筐体内に基板を搬入出するために、前記筐体の側面をなす第1の面に設けられた基板搬入出口と、

前記筐体内に基板を搬入するために、前記筐体の側面をなす、前記第1の面と直交する第2の面に設けられた基板搬入口と、

40

前記筐体内から基板を搬出するために、前記筐体の側面をなす、前記第2の面と対向する第3の面に設けられた基板搬出口と、

を有し、

前記第1の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入出口を介して基板の搬入出が行われ、前記第2の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口から基板が搬入され前記基板搬出口から基板が搬出されることを特徴とする処理ユニットを提供する。

【0012】

本発明の第2の観点では、搬送路に沿って基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが配置され、搬送路を移動する搬送装置により前記搬送路に沿って設けられた各処理ユ

50

ニットに対する基板の搬送を行い、基板に対して一連の処理を行う第1の処理装置と、  
基板に所定の処理を施す複数の処理ユニットが処理の順に配列され、これら複数の処理  
ユニットに基板を順次搬入して、基板に対して一連の処理を行う第2の処理装置と、を具備  
する処理システムであって、

前記第1の処理装置および前記第2の処理装置は、いずれにも搭載可能な処理ユニット  
を有しており、それらは入れ替え可能に構成されており、

前記いずれにも搭載可能な処理ユニットは、  
外装をなす矩形状の筐体と、

前記筐体内に基板を搬入出するために、前記筐体の側面をなす第1の面に設けられた基  
板搬入口と、

前記筐体内に基板を搬入するために、前記筐体の側面をなす、前記第1の面と直交する  
第2の面に設けられた基板搬入口と、

前記筐体内から基板を搬出するために、前記筐体の側面をなす、前記第2の面と対向す  
る第3の面に設けられた基板搬出口と、

を有し、

前記第1の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口を介して基板の搬入出が行  
われ、前記第2の処理装置に搭載された際には、前記基板搬入口から基板が搬入され前記  
基板搬出口から基板が搬出されることを特徴とする処理システムを提供する。

#### 【0013】

本発明によれば、その側面の3方向に基板の搬入および/または搬出のための開口を有  
するようにして処理ユニットを構成するので、中央搬送タイプの処理装置用に1方向側の  
開口を用い、トラック搬送タイプの処理装置用に他の2方向側の開口を用いることができ  
、中央搬送タイプの処理装置にもトラック搬送タイプの処理装置にも適用することが可能  
となる。

#### 【0014】

また、中央搬送タイプの処理装置と、トラック搬送タイプの処理装置とを備えた処理  
システムにおいて、これら2つの処理装置が、いずれにも搭載可能な処理ユニットを有して  
おり、それらを入れ替え可能に設けることにより、中央搬送タイプの処理装置用とトラック  
搬送タイプの処理装置用とで区別することなく処理ユニットを製造することができるの  
で効率的であるとともに、一方の処理装置から他方の処理装置への処理ユニットの付け替  
えを行うことができ、自由度の高い処理システムが実現される。

#### 【0015】

##### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

図1は、本発明が適用されるLCD基板のレジスト塗布・現像処理システムを示す平面  
図である。

#### 【0016】

このレジスト塗布・現像処理システム300は、中央搬送タイプの第1の処理装置10  
0と、トラック搬送タイプの第2の処理装置200を備えている。

#### 【0017】

中央搬送タイプの第1の処理装置100は、複数の基板Gを収容するカセットCを載置  
するカセットステーション1と、基板Gにレジスト塗布および現像を含む一連の処理を施  
すための複数の処理ユニットを備えた処理部2と、露光装置40との間で基板Gの受け渡  
しを行うためのインターフェイス部3とを備えており、処理部2の両端にそれぞれカセッ  
トステーション1およびインターフェイス部3が配置されている。

#### 【0018】

カセットステーション1は、カセットCと処理部2との間でLCD基板Gの搬送を行  
うための搬送機構10を備えている。そして、カセットステーション1においてカセットC  
の搬入出が行われる。また、搬送機構10はカセットの配列方向に沿って設けられた搬送  
路10a上を移動可能な搬送アーム11を備え、この搬送アーム11によりカセットCと

処理部 2 との間で基板 G の搬送が行われる。

**【 0 0 1 9 】**

処理部 2 は、前段部 2 a と中段部 2 b と後段部 2 c とに分かれしており、それぞれ中央に搬送路 1 2 、 1 3 、 1 4 を有し、これら搬送路の両側に各処理ユニットが配設されている。そして、これらの間には中継部 1 5 、 1 6 が設けられている。

**【 0 0 2 0 】**

前段部 2 a は、搬送路 1 2 に沿って移動可能な主搬送装置 1 7 を備えており、搬送路 1 2 の一方側には、2つの洗浄ユニット ( S C R ) 2 1 a 、 2 1 b が配置されており、搬送路 1 2 の他方側には紫外線照射ユニット ( U V ) と冷却ユニット ( C O L ) とが2段に重ねられた処理ブロック 2 5 、加熱処理ユニット ( H P ) が2段に重ねられてなる処理ブロック 2 6 および冷却ユニット ( C O L ) が2段に重ねられてなる処理ブロック 2 7 が配置されている。

10

**【 0 0 2 1 】**

また、中段部 2 b は、搬送路 1 3 に沿って移動可能な主搬送装置 1 8 を備えており、搬送路 1 3 の一方側には、基板 G にレジストを塗布するレジスト塗布処理セクション ( C T ) 2 2 a および基板 G の周縁部のレジストを除去する周縁レジスト除去セクション ( E R ) 2 2 b が一体的に設けられたレジスト処理ユニット 2 2 が配置されており、搬送路 1 3 の他方側には、加熱処理ユニット ( H P ) が2段に重ねられてなる処理ブロック 2 8 、加熱処理ユニット ( H P ) と冷却処理ユニット ( C O L ) が上下に重ねられてなる処理ブロック 2 9 、およびアドヒージョン処理ユニット ( A D ) と冷却ユニット ( C O L ) とが上下に重ねられてなる処理ブロック 3 0 が配置されている。

20

**【 0 0 2 2 】**

さらに、後段部 2 c は、搬送路 1 4 に沿って移動可能な主搬送装置 1 9 を備えており、搬送路 1 4 の一方側には、3つの現像処理ユニット ( D E V ) 2 4 a 、 2 4 b 、 2 4 c が配置されており、搬送路 1 4 の他方側には加熱処理ユニット ( H P ) が2段に重ねられてなる処理ブロック 3 1 、およびともに加熱処理ユニット ( H P ) と冷却処理ユニット ( C O L ) が上下に重ねられてなる処理ブロック 3 2 、 3 3 が配置されている。

30

**【 0 0 2 3 】**

上記主搬送装置 1 7 、 1 8 、 1 9 は、それぞれ水平面内の2方向の X 軸駆動機構、 Y 軸駆動機構、および垂直方向の Z 軸駆動機構を備えており、さらに Z 軸を中心に回転する回転駆動機構を備えており、それぞれ基板 G を支持するアーム 1 7 a 、 1 8 a 、 1 9 a を有している。

**【 0 0 2 4 】**

上記主搬送装置 1 7 は、搬送機構 1 0 の搬送アーム 1 1 との間で基板 G の受け渡しを行うとともに、前段部 2 a の各処理ユニットに対する基板 G の搬入・搬出、さらには中継部 1 5 との間で基板 G の受け渡しを行う機能を有している。また、主搬送装置 1 8 は中継部 1 5 との間で基板 G の受け渡しを行うとともに、中段部 2 b の各処理ユニットに対する基板 G の搬入・搬出、さらには中継部 1 6 との間の基板 G の受け渡しを行う機能を有している。さらに、主搬送装置 1 9 は中継部 1 6 との間で基板 G の受け渡しを行うとともに、後段部 2 c の各処理ユニットに対する基板 G の搬入・搬出、さらにはインターフェイス部 3 との間の基板 G の受け渡しを行う機能を有している。なお、中継部 1 5 、 1 6 は冷却ブレートとしても機能する。

40

**【 0 0 2 5 】**

インターフェイス部 3 は、処理部 2 との間で基板を受け渡しする際に一時的に基板を保持するエクステンション 3 6 と、さらにその両側に設けられた、バッファーカセットを配置する2つのバッファーステージ 3 7 と、これらと露光装置 4 0 との間の基板 G の搬入出を行う搬送機構 3 8 とを備えている。搬送機構 3 8 はエクステンション 3 6 およびバッファーステージ 3 7 の配列方向に沿って設けられた搬送路 3 8 a 上を移動可能な搬送アーム 3 9 を備え、この搬送アーム 3 9 により処理部 2 と露光装置 4 0 との間で基板 G の搬送が行われる。

50

**【0026】**

このような中央搬送タイプの第1の処理装置100では、カセットステーション1から取り出された基板Gは、処理部2に搬送された後、主搬送装置17, 18, 19により搬送されて、処理部2の各ユニットにおいて紫外線照射処理、スクラバ洗浄処理、アドヒージョン処理、レジスト塗布処理、およびブリペーク処理等が施された後、インターフェイス部3を介して露光装置40に基板Gを搬送して露光処理を行い、その後、インターフェイス部3を介して再び処理部2に搬入され、現像処理、ポストペーク処理等が施されて一連の処理が終了した後、カセットステーション1に戻され、いずれかのカセットCに収容される。

**【0027】**

10

次に、トラック搬送タイプの第2の処理装置200について説明する。この第2の処理装置200は、複数の基板Gを収容するカセットCを載置し、基板Gを搬入するためのローダ部101と、基板Gにレジスト塗布および現像を含む一連の処理を施すための複数の処理ユニットを備えた処理部102と、露光装置140との間で基板Gの受け渡しを行うためのインターフェイス部103と、カセットCを載置し、処理後の基板Gを搬出するためのアンローダ部104とを備えている。

**【0028】**

ローダ部101は、カセットCから処理部102へLCD基板Gの搬送を行うための搬送機構110を備えている。搬送機構110は搬送路111上を移動可能な搬送アーム112を備え、この搬送アーム112によりカセットCから処理部102へ基板Gが搬送される。

20

**【0029】**

処理部102は、ローダ部101からインターフェイス部103に至る前段部102aと、インターフェイス部103からアンローダ部104に至る後段部102bとを有しており、処理の順に各処理ユニットが配列されている。

**【0030】**

前段部102aは、ローダ部101側から紫外線照射ユニット(UV)121、冷却処理ユニット(COL)122、スクラバ洗浄ユニット(SRC)123、アドヒージョン処理ユニット(AD)124、冷却処理ユニット(COL)125、レジスト塗布処理セクション(CT)126aおよび周縁レジスト除去セクション(ER)126bが一体的に設けられたレジスト処理ユニット126、加熱処理ユニット(HP)127、冷却処理ユニット(COL)128が順に配列されており、この冷却処理ユニット(COL)128からインターフェイス部103へ基板Gが搬送されるようになっている。隣接する処理ユニットの間、および冷却処理ユニット(COL)128とインターフェイス部103との間には、それぞれ搬送機構Tが設けられており、これら搬送機構Tによって配列された処理ユニットに順次基板が搬送される。

30

**【0031】**

後段部102bは、インターフェイス部103側から現像処理ユニット(DEV)129、加熱処理ユニット(HP)130、冷却処理ユニット(COL)131が順に配列されており、この冷却処理ユニット(COL)131からアンローダ部104へ基板Gが搬送されるようになっている。インターフェイス部103と現像処理ユニット(DEV)129との間、および隣接する処理ユニットの間には、それぞれ搬送機構Tが設けられており、これら搬送機構Tによって配列された処理ユニットに順次基板が搬送される。

40

**【0032】**

インターフェイス部103は、処理部102から搬入された基板Gを一時的に保持するエクステンション132と、処理部102へ搬出する基板Gを一時的に保持するエクステンション133と、これらエクステンション132および133の外側に設けられた、バッファーカセットを配置する2つのバッファーステージ134と、これらと露光装置140との間の基板Gの搬入出を行う搬送機構135とを備えている。搬送機構135はエクステンション132、133およびバッファーステージ134の配列方向に沿って設けられ

50

た搬送路 136 上を移動可能な搬送アーム 137 を備え、この搬送アーム 137 により処理部 102 と露光装置 140 との間で基板 G の搬送が行われる。

#### 【0033】

アンローダ部 104 は、処理部 102 からカセット C へ LCD 基板 G の搬送を行うための搬送機構 150 を備えている。搬送機構 150 は搬送路 151 上を移動可能な搬送アーム 152 を備え、この搬送アーム 152 により処理部 102 からカセット C へ基板 G が搬送される。

#### 【0034】

このようなトラック搬送タイプの第 2 の処理装置 200 では、ローダ部 101 から取り出された基板 G は、処理部 102 に搬送され、処理部 102 に処理の順に配列された各処理ユニットにおいて、紫外線照射処理、スクラバ洗浄処理、アドヒージョン処理、レジスト塗布処理、およびプリベーク処理等が施された後、インターフェイス部 103 を介して露光装置 140 に基板 G を搬送して露光処理を行い、その後、インターフェイス部 103 を介して再び処理部 102 に搬入され、現像処理、ポストベーク処理等が施されて一連の処理が終了した後、アンローダ部 104 のカセット C に収容される。

10

#### 【0035】

次に、このような処理システムに用いられる処理ユニットについて説明する。本実施形態においては、上記第 1 の処理装置 100 および第 2 の処理装置 200 は、いずれにも搭載可能な処理ユニットを有しており、それらは入れ替え可能に構成されている。また、このような入れ替えをスムーズに行うため、このようないずれの処理装置にも搭載可能な処理ユニットは、オペレータが容易に着脱することができるよう構成されている。

20

#### 【0036】

このような両方のタイプの処理装置に搭載可能な処理ユニットとしては、オープン型の処理ユニットおよびスピナ系処理ユニットの両方が適用可能である。

#### 【0037】

オープン型の処理ユニットである加熱処理ユニット (HP) は、図 2 の水平断面図に示すように、矩形状の筐体 201 を有しており、その中に加熱プレート 202 が設けられている。加熱プレート 202 は、図示しない発熱体により加熱されるようになっており、この加熱プレート 202 の表面に基板 G を近接または載置することにより基板 G の加熱処理が行われる。また、加熱プレート 202 には、その表面に対して突没自在に複数のリフトピン 203 が設けられており、基板 G の搬送の際にこれらリフトピン 203 によって基板 G が昇降される。

30

#### 【0038】

筐体 201 には、その 3 方向に基板 G の搬入および / または搬出のための開口 204, 205, 206 が形成されている。これら開口 204, 205, 206 には、それぞれシャッター 207, 208, 209 が開閉自在に設けられている。

#### 【0039】

開口 204 の間口は、基板 G の長辺の長さに対応しており、中央搬送タイプの処理装置 100 に搭載された際に搬送路側に面しているこの開口 204 を用いて基板 G の搬入および搬出を行うことが可能である。また、開口 205 および 206 は互いに対向して設けられ、これらの間口は基板 G の短辺の長さに対応しており、トラック搬送タイプの処理装置 200 に搭載された際に、それぞれ基板 G の搬出および搬入を行い処理ユニット内を通過させることが可能である。

40

#### 【0040】

このように、中央搬送タイプの処理装置 100 用の基板 G の搬入および搬出口として、筐体 201 の一方向に設けられた開口 204 を用いることができ、トラック搬送タイプの処理装置 200 用の基板 G の搬入口として開口 206、搬出口として開口 205 を用いることができるので、このような加熱処理ユニット (HP) は中央搬送タイプの処理装置 100 にもトラック搬送タイプの処理装置 200 にも搭載することが可能である。

#### 【0041】

50

なお、加熱処理ユニット(HP)以外の他のオープン型ユニット、例えば冷却処理ユニット(COL)やアドーヒージョン処理ユニット(AD)も同様に構成することができる。

#### 【0042】

次に、中央搬送タイプの処理装置100およびトラック搬送タイプの処理装置200のいずれにも搭載可能なスピナ系処理ユニットである現像処理ユニット(DEV)は、図3の水平断面図に示すように、矩形状の筐体221を有しており、その中に基板Gを吸着保持する水平回転可能なスピンチャック222が設けられている。また、このスピンチャック222により保持された基板Gを包囲するように円筒形状のインナーカップ223が設けられ、このインナーカップ223の外周囲を取り囲むように円筒形状のアウターカップ224が設けられている。10

#### 【0043】

筐体221には、その3方向に基板Gの搬入および/または搬出のための開口225, 226, 227が形成されている。これら開口225, 226, 227には、それぞれシャッター228, 229, 230が開閉自在に設けられている。

#### 【0044】

開口225の間口は、基板Gの長辺の長さに対応しており、中央搬送タイプの処理装置100に搭載された際に搬送路側に面しているこの開口225を用いて基板Gの搬入および搬出を行うことが可能である。また、開口226および227は互いに対向して設けられ、これらの間口は基板Gの短辺の長さに対応しており、トラック搬送タイプの処理装置200に搭載された際に、それぞれ基板Gの搬出および搬入を行い処理ユニット内を通過させることができる。20

#### 【0045】

筐体221の開口が設けられていない壁部231側には、処理に必要な処理ツールを一括して配置してなる処理ツール系232が存在している。この処理ツール系232は、現像液ノズル233を搭載した現像液用ノズルアーム234と、現像液用ノズルアーム234を駆動する駆動系235と、 rins液ノズル236を搭載した rins液用ノズルアーム237と、 rins液用ノズルアーム237を駆動する駆動系238とを有している。現像液ノズル233から現像液を吐出する際には、現像液用ノズルアーム234が図示しないガイドに沿って移動し、基板G上をスキャンするようになっている。また、 rins液ノズル236から rins液を吐出する際には、 rins液用ノズルアーム237を回動させて rins液ノズル236を基板Gの中心に位置させる。30

#### 【0046】

このような現像処理ユニット(DEV)では、現像液ノズル233から現像液を吐出させて基板Gの全面に塗布し現像処理を進行させ、現像処理終了後、スピンチャック222により基板Gを回転させながら rins液ノズル236から rins液を供給して現像液を除去した後、スピンチャック222により基板Gを高速回転させて基板Gの振り切り乾燥を行う。

#### 【0047】

このように、現像処理ユニット(DEV)においても、中央搬送タイプの処理装置100用の基板Gの搬入および搬出口として、筐体221の一方向に設けられた開口225を用いることができ、トラック搬送タイプの処理装置200用の基板Gの搬入口として開口227、搬出口として開口226を用いることができるので、このような現像処理ユニット(DEV)は中央搬送タイプの処理装置100にもトラック搬送タイプの処理装置200にも搭載することができる。40

#### 【0048】

また、処理に必要な処理ツールを一括して配置してなる処理ツール系232を筐体221の開口が設けられていない壁部231側に存在させたので、中央搬送タイプの処理装置100に搭載された場合も、トラック搬送タイプの処理装置200に搭載された場合も、処理ツール系232に妨げられることなく基板Gの搬入出をスムーズに行うことができる50

。

### 【0049】

なお、現像処理ユニット(DEV)以外の他のスピナ系ユニット、例えばスクラバ洗浄処理ユニット(SCR)やレジスト塗布処理ユニット(CT)も同様に構成することができる。ただし、本実施形態の処理システムではレジスト塗布処理ユニット単独ではなく、レジスト塗布処理セクション(CT)と周縁レジスト除去セクション(ER)とが一体となったレジスト処理ユニット22,126として以下のように構成されている。

### 【0050】

レジスト処理ユニット22,126は、図4の水平断面図に示すように、矩形状の筐体241を有しており、その中にレジスト塗布処理セクション(CT)および周縁レジスト除去セクション(ER)が一体的に併設されている。筐体241は、レジスト塗布処理セクション(CT)および周縁レジスト除去セクション(ER)の配列方向に延びる一対の長辺242,243と、これらに直交する一対の短辺244,245を有している。

10

### 【0051】

筐体241の一方の長辺242には、レジスト塗布処理セクション(CT)へ基板Gを搬入するための開口246と、周縁レジスト除去セクション(ER)から基板Gを搬出するための開口247とが設けられている。また、レジスト塗布処理セクション(CT)側の短辺244にはレジスト塗布処理セクション(CT)へ基板Gを搬入するための開口248が設けられ、周縁レジスト除去セクション(ER)側の短辺245には周縁レジスト除去セクション(ER)から基板Gを搬出するための開口249が設けられている。これら開口246,247,248,249には、それぞれシャッター250,251,252,253が開閉自在に設けられている。

20

### 【0052】

レジスト塗布処理セクション(CT)は、基板Gを吸着保持する水平回転可能なスピーチャック254、このスピーチャック254の上端部を囲みかつこのスピーチャック254に吸着保持された基板Gを包囲するとともに回転可能に構成された上端部が開口する有底開口円筒形状の回転カップ255、回転カップ255の外周を取り囲むように固定配置された外側カップ256、さらにその外側に設けられドレインを取り回収するドレインカップ257を有している。また、回転カップ255の上端開口には、図示しない蓋体が装着されるようになっている。そして、後述するレジストの滴下時には、蓋体が開かれた状態で基板Gがスピーチャック254により回転され、レジストの拡散時には、基板Gがスピーチャック254により回転されると同時に、蓋体が閉じられた状態の回転カップ255が回転されるようになっている。

30

### 【0053】

筐体241の他方の長辺243側には、基板Gにレジスト液を吐出するためのレジスト液吐出ノズル258およびレジストに先立って基板Gに供給される溶剤(例えばシンナー)を吐出するための溶剤吐出ノズル259を搭載したノズルアーム260と、このノズルアーム260を駆動する駆動系261とが設けられている。レジスト液または溶剤を基板Gに吐出する際には、レジスト液吐出ノズル258または溶剤吐出ノズル259が基板Gの中心に位置するようにノズルアーム260が回動されるようになっている。

40

### 【0054】

周縁レジスト除去セクション(ER)は、基板Gを載置するためのステージ262を有している。また、ステージ262に載置された基板Gの各辺に対応する位置には、それぞれ基板Gの四辺のエッジから余分なレジストを除去するための四個のリムーバーヘッド263が設けられている。各リムーバーヘッド263は、内部からシンナーを吐出するよう断面略U字状を有し、基板Gの四辺に沿って移動機構(図示略)によって移動されるようになっている。このように、リムーバーヘッド263が基板Gの各辺に沿って移動してシンナーを吐出することにより、基板Gの四辺の周縁部に付着した余分なレジストを取り除くことができる。

### 【0055】

50

レジスト塗布処理セクション(CT)で所定の色彩レジストが塗布された基板Gは、一对のサブアーム264により周縁レジスト除去セクション(ER)に搬送されるようになっている。サブアーム264は図示しないガイドレールに沿ってレジスト塗布処理セクション(CT)と周縁レジスト除去セクション(ER)との間を移動するようになっている。

#### 【0056】

このようなレジスト処理ユニット22,126においては、まず、レジスト塗布処理セクション(CT)において、スピンドル254により基板Gが回転され、溶剤ノズル259が基板Gの中心に位置するようにノズルアーム260が回動され、溶剤ノズル259から回転する基板Gの表面に溶剤が供給され、遠心力によって基板Gの中心からその周囲全域にむらなく広げられる。続いて、レジスト吐出ノズル258が基板Gの中心に位置するようにノズルアーム260が回動され、基板Gにレジスト液が吐出され、スピンドル254を回転させた際の遠心力によって基板Gの中心からその周囲全域にむらなく広げられる。その後蓋体を装着してスピンドル254および回転カップ255を回転させることにより膜厚を整える。

#### 【0057】

このようにレジストが塗布された基板Gは、サブアーム264により周縁レジスト除去セクション(ER)に向けて搬送され、ステージ262に載置される。そして、4個のリムーバーヘッド263がシンナーを吐出させた状態で基板Gの各辺に沿って移動され、吐出されたシンナーにより基板Gの四辺のエッジに付着した余分なレジストが除去される。

#### 【0058】

このようなレジスト処理ユニット22,126においては、中央搬送タイプの処理装置100用の基板Gの搬入口および搬出口として、それぞれ筐体241の搬送路側に面している一方の長辺242の開口246および277を用いることができ、トラック搬送タイプの処理装置200用の基板Gの搬入口として筐体241の短辺244に設けられた開口248、搬出口として短辺245に設けられた開口249を用いて処理ユニット内を通過させることができるので、このようなレジスト処理ユニット22,126は中央搬送タイプの処理装置100にもトラック搬送タイプの処理装置200にも搭載することができる。また、レジスト塗布セクション(CT)のノズルアーム260および駆動系261を筐体241の開口が設けられていない長辺243側に存在させたので、中央搬送タイプの処理装置100に搭載された場合も、トラック搬送タイプの処理装置200に搭載された場合も、ノズルアーム260および駆動系261に妨げられることなく基板Gの搬入出をスムーズに行うことができる。なお、上記各処理ユニットで使用する開口は、処理ユニットが配置される処理装置によって異なるが、処理装置に対応して手動または自動にて使用する開口を設定可能に構成しておくことにより、処理ユニットの付け替えがあった場合でも使用する開口の設定が容易である。

#### 【0059】

以上のように、中央搬送タイプの処理装置100と、トラック搬送タイプの処理装置200とを備えた処理システム300において、これら2つの処理装置100,200が、いずれにも搭載可能な処理ユニットを有しており、それらが入れ替え可能であるから、中央搬送タイプの処理装置用とトラック搬送タイプの処理装置用とで区別することなく処理ユニットを製造することができるので効率的であるとともに、一方の処理装置から他方の処理装置への処理ユニットの付け替えを行うことができ、自由度の高い処理システムが実現される。また、これら処理ユニットはオペレータが容易に着脱することができるため、これら処理ユニットの付け替えが容易である。さらに、予備の処理ユニットとして、上記構造のものを準備しておけば、中央搬送タイプの処理装置100およびトラック搬送タイプ200のいずれの処理ユニットが故障しても対応することが可能となる。

#### 【0060】

なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、中央搬送タイプの処理装置とトラック搬送タイプの処理装置とを別個に設

10

20

30

40

50

けて処理システムを構成したが、これらが一体化されたシステムであってもよいことはもちろんである。また、上記実施形態で示した全ての処理ユニットが処理装置に搭載されている必要はなく、その一部であってもよい。さらにまた、装置レイアウトも上記実施形態に限るものではなく、処理に応じて適宜のレイアウトを採用すればよい。さらにまた、処理に関しても上記のようにレジスト塗布現像装置による処理に限るものではなく、基板としてもLCD基板に限らずカラーフィルター等の他の基板の処理の場合にも適用可能であることはいうまでもない。

### 【0061】

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、その側面の3方向に基板の搬入および／または搬出のための開口を有するようにして処理ユニットを構成するので、中央搬送タイプの処理装置用に1方向側の開口を用い、トラック搬送タイプの処理装置用に他の2方向側の開口を用いることができ、中央搬送タイプの処理装置にもトラック搬送タイプの処理装置にも適用することが可能となる。

10

### 【0062】

また、中央搬送タイプの処理装置と、トラック搬送タイプの処理装置とを備えた処理システムにおいて、これら2つの処理装置が、いずれにも搭載可能でな処理ユニットを有しており、それらを入れ替え可能に設けたので、中央搬送タイプの処理装置用とトラック搬送タイプの処理装置用とで区別することなく処理ユニットを製造することができるので効率的であるとともに、一方の処理装置から他方の処理装置への処理ユニットの付け替えを行うことができ、自由度の高い処理システムが実現される。

20

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明が適用されるLCD基板のレジスト塗布・現像処理システムを示す平面図。

【図2】 図1のレジスト塗布・現像処理システムに搭載された加熱処理ユニット(HP)を示す水平断面図。

【図3】 図1のレジスト塗布・現像処理システムに搭載された現像処理ユニット(DEV)を示す水平断面図。

【図4】 図1のレジスト塗布・現像処理システムに搭載されたレジスト処理ユニットを示す水平断面図。

30

#### 【符号の説明】

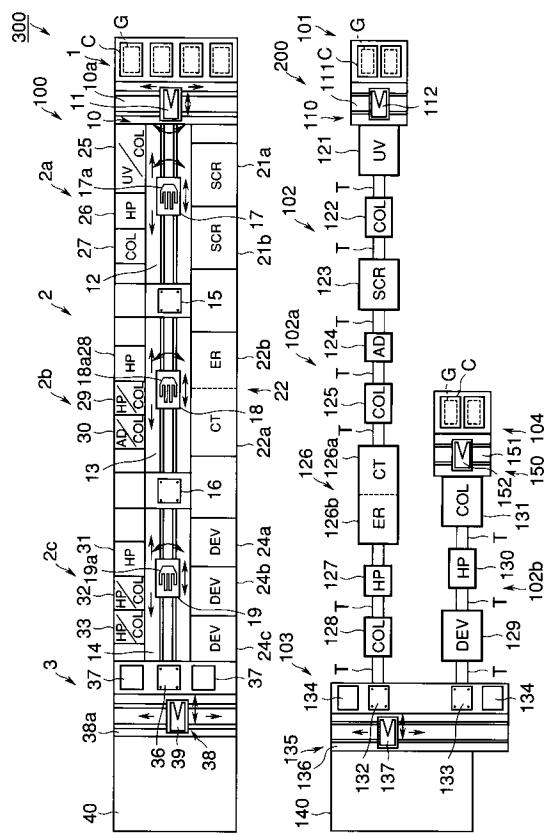
- 1 ..... カセットステーション
- 2, 102 ..... 処理部
- 3, 103 ..... インターフェイス部
- 12, 13, 14 ..... 搬送路
- 17, 18, 19 ..... 主搬送装置
- 22, 126 ..... レジスト処理ユニット
- 100 ..... 第1の処理装置(中央搬送タイプの処理装置)
- 101 ..... ローダ部
- 104 ..... アンローダ部
- 200 ..... 第2の処理装置(トラック搬送タイプの処理装置)
- 201, 221, 241 ..... 筐体
- 204, 205, 206, 225, 226, 227, 246, 247, 248, 249 ..... 開口
- 300 ..... レジスト塗布・現像処理システム
- SCR ..... スクラバ洗浄処理ユニット
- CT ..... レジスト塗布処理セクション
- ER ..... 周縁レジスト除去セクション
- DEV ..... 現像処理ユニット
- HP ..... 加熱処理ユニット

40

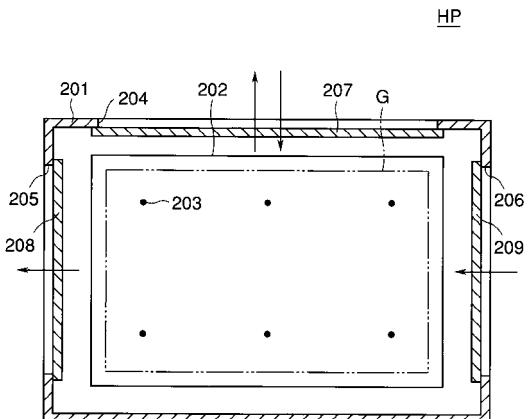
50

C O L ..... 冷却処理ユニット  
 A D ..... アドヒージョン処理ユニット  
 U V ..... 紫外線照射ユニット  
 G ..... L C D 基板  
 T ..... 搬送機構

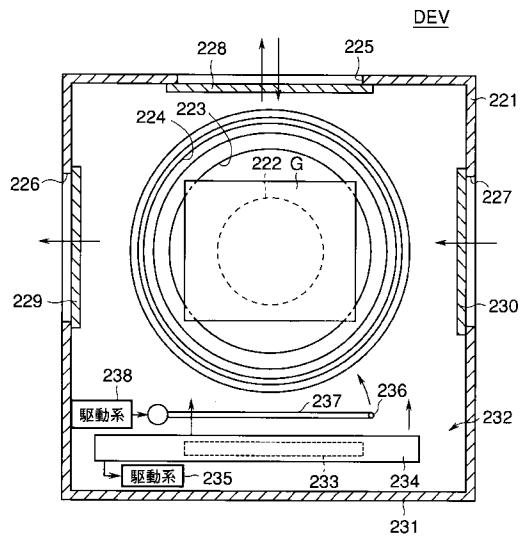
【図1】



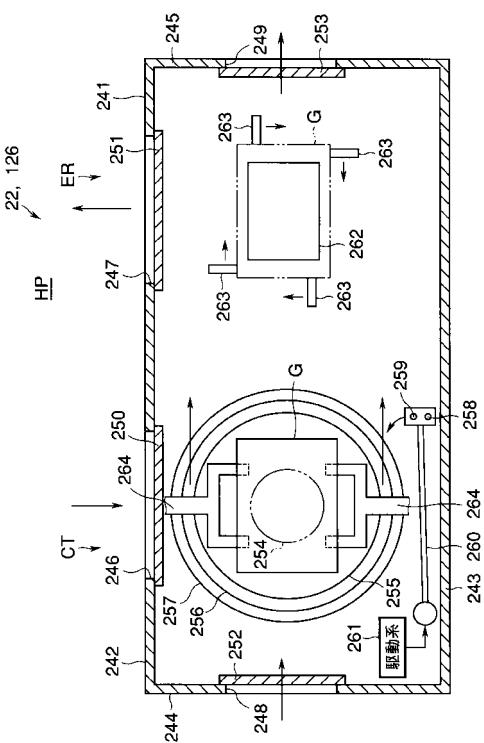
【図2】



【 図 3 】



【 図 4 】



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平11-186358(JP,A)  
特開平10-247674(JP,A)  
特開平10-031316(JP,A)  
特開平10-177945(JP,A)  
特開平04-097526(JP,A)  
特開昭63-287016(JP,A)  
特開昭63-013332(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 21/027  
B65G 49/06  
G03F 7/16  
G03F 7/30  
H01L 21/677